

Ultra High Performance BGA Cooling Solutions w/ maxiGRIP™ Attachment



ATS Part#: **ATS-51350D-C1-R0**
 Description: maxiFLOW™ maxiGRIP™ HS Assembly- LP, T766, BLACK- ANODIZED

Heat Sink Type: **maxiFLOW**
 Heat Sink Attachment: **maxiGRIP**
 Equivalent Part Number: **ATS-51350D-C2-R0 Discontinued**

**Image above is for illustration purpose only.*

Features & Benefits

- **maxiFLOW™** design features a low profile, spread fin array that maximizes surface area for more effective convection (air) cooling
- **maxiGRIP™** attachment applies steady, even pressure to the component and does not require holes in the PCB
- Meets Telcordia GR-63-Core Office Vibration; ETSI 300 019 Transportation Vibration; and MIL-STD-810 Shock and Unpackaged Drop Testing standards
- Comes pre-assembled with high performance, phase changing, thermal interface material
- Designed for low profile components from 1.5 to 2.99mm
- "Keep-Out" Requirements: An "Un-Populated" border zone of 5mm around the component is necessary to facilitate the Installation/Removal of the **maxiGRIP™**. Please refer to the **maxiGRIP™** Keep-Out Guidelines and **maxiGRIP™** Installation/Removal Instructions for further details.

Thermal Performance

| AIR VELOCITY | | @200 LFM 1.0 M/S | @300 LFM 1.5 M/S | @400 LFM 2.0 M/S | @500 LFM 2.5 M/S | @600 LFM 3.0 M/S | @700 LFM 3.5 M/S | @800 LFM 4.0 M/S |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| THERMAL RESISTANCE | Unducted Flow | 5.27 °C/W | 3.89 °C/W | 3.26 °C/W | 2.89 °C/W | 2.62 °C/W | 2.43 °C/W | 2.27 °C/W |
| | Ducted Flow | 3.08 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |

Product Detail

| Schematic Image | Dimension A | Dimension B | Dimension C | Dimension D | TIM | Finish |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|------|-----------------|
| <p><i>*Image above is for illustration purpose only.</i></p> | 35.0 mm | 35.0 mm | 9.5 mm | 44.9 mm | T766 | BLACK- ANODIZED |
| <p>Notes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimension A and B refer to component size. • Dimension C is the heat sink height from the bottom of the base to the top of the fin field. • ATS-51350D-C2-R0 is the exact heat sink assembly with an equivalent thermal interface material (Saint Gobain C1100F). NOTE: Saint Gobain C1100F is discontinued effective 12/31/10. • Thermal performance data are provided for reference only. Actual performance may vary by application. • ATS reserves the right to update or change its products without notice to improve the design or performance. • ATS certifies that this heat sink assembly is RoHS-6 and REACH compliant. • Optional maxiGRIP™ Installation/Removal Tool Set P/N: MGT350 • Contact ATS to learn about custom options available. | | | | | | |

For more information, to find a distributor or to place an order, please contact us at 781-769-2800 (North America), sales@qats.com or www.qats.com.

© 2012 Advanced Thermal Solutions, Inc. | 89-27 Access Road | Norwood MA | 02062 | USA





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.